

TPS92663-Q1 車載用ヘッドライト・システム向けの高輝度 LED マトリクス・マネージャ

1 特長

- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
 - デバイス温度グレード 1: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ 、 T_A
 - デバイス HBM 分類レベル: H1C
 - デバイス CDM 分類レベル: C5
- 入力電圧範囲: 4.5V~60V
- 6つのバイパス・スイッチを内蔵
 - 3つの直列スイッチを含む、2本のサブストリング
 - スイッチごとの最大電圧: 20V
 - スイッチ-GND間の最大電圧: 62V
- マルチドロップ UART 通信インターフェイス
 - 最大 16のデバイスをアドレス指定可能
 - TPS92662-Q1 と同じバスに統合
- CAN 物理レイヤと互換
 - 最低限のケーブル・ハーネス内ワイヤ数
- 2つの多重化入力を持つ 8ビット ADC
- 水晶発振器ドライバ
- プログラム可能な 10ビット PWM 調光
 - 個別の位相シフトおよびパルス幅
 - デバイス間の同期
- LED の開放および短絡検出および保護

2 アプリケーション

- 車載ヘッドライト・システム
- 高輝度 LED マトリクス・システム
- ADB またはグレアなしのハイビーム
- シーケンシャル・ターン、およびアニメーション付きの日中点灯用ライト

3 概要

TPS92663-Q1 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、各ピクセルのレベルを LED で制御できるため、完全にダイナミックな適応型ライティング・ソリューションを実現できます。

このデバイスには 2 つのサブストリングが含まれ、各サブストリングは個別の LED をバイパスする、直列接続された 3 つの内蔵スイッチで構成されます。個別のサブストリングにより、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。これにより、2 つのスイッチを並列接続し、大電流 LED をバイパスすることもできます。

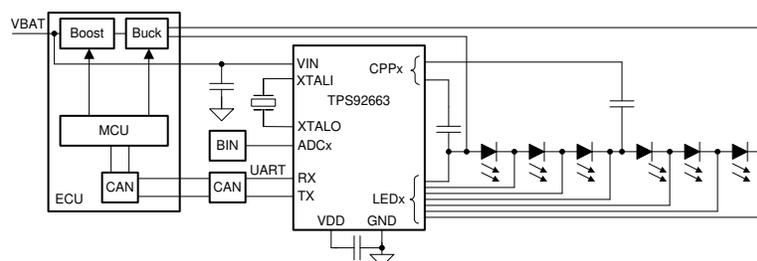
マスタ・マイクロコントローラは、マルチドロップの UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) シリアル・インターフェイスで TPS92663-Q1 デバイスを制御および管理します。シリアル・インターフェイスは CAN トランシーバの使用をサポートしているため、より強固な物理レイヤを形成できます。アプリケーションは、同じバスで TPS92663-Q1 デバイスと TPS92662-Q1 デバイスを使用できます。

製品情報⁽¹⁾

型番	パッケージ	本体サイズ(公称)
TPS92663-Q1	PWP (24)	7.70mmx4.40mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

アプリケーション概略図



目次

1	特長	1	6.1	ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	4
2	アプリケーション	1	6.2	コミュニティ・リソース	4
3	概要	1	6.3	商標	4
4	改訂履歴.....	2	6.4	静電気放電に関する注意事項	4
5	概要 (続き).....	3	6.5	Glossary	4
6	デバイスおよびドキュメントのサポート.....	4	7	メカニカル、パッケージ、および注文情報	5

4 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	リビジョン	注
2018年7月	*	初版

5 概要 (続き)

デバイスに搭載された、2つの多重化された入力を持つ8ビットADCをシステムの温度補償に使用できます。また、ビン値を測定してLEDのビン値とコーディングを行うこともできます。

内部のチャージ・ポンプのレールにより、LEDバイパス・スイッチのゲート・ドライブ電圧を供給します。バイパス・スイッチのオン抵抗 ($R_{DS(on)}$) が低いいため、伝導損失と消費電力を最小化できます。

ストリング内で、各LEDの位相シフトとパルス幅をプログラム可能です。このデバイスは、内部レジスタを使用してPWM周波数を調整します。複数のデバイスの同期が可能です。PWM調光動作時のスイッチ遷移のスルー・レートをプログラムすることで、EMIの懸念を緩和できます。

このデバイスは、スレッシュホールドをプログラム可能なLED開放保護機能を備えています。シリアル・インターフェイスによって、LEDの開放または短絡フォルトが通知されます。

6 デバイスおよびドキュメントのサポート

6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の「アラートを受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

6.2 コミュニティ・リソース

[TI E2E™ support forums](#) are an engineer's go-to source for fast, verified answers and design help — straight from the experts. Search existing answers or ask your own question to get the quick design help you need.

Linked content is provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's [Terms of Use](#).

6.3 商標

E2E is a trademark of Texas Instruments.

6.4 静電気放電に関する注意事項



すべての集積回路は、適切なESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。

静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るまで、様々な損傷を与えます。高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかなパラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しなくなる場合があります。

6.5 Glossary

[SLYZ022](#) — *TI Glossary*.

This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.

7 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、そのデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TPS92663QPWRQ1	ACTIVE	HTSSOP	PWP	24	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	TPS92663Q	Samples
TPS92663QPWPTQ1	ACTIVE	HTSSOP	PWP	24	250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	TPS92663Q	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

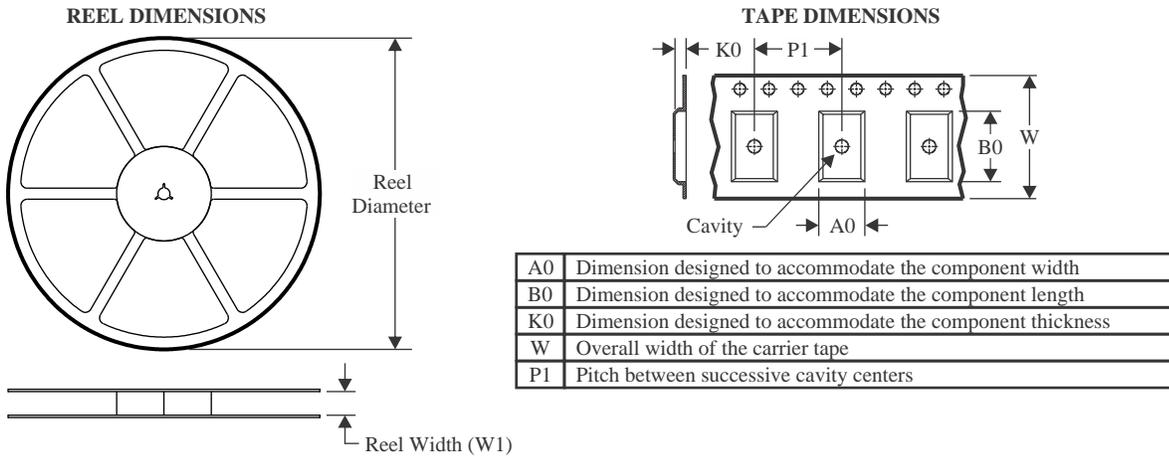
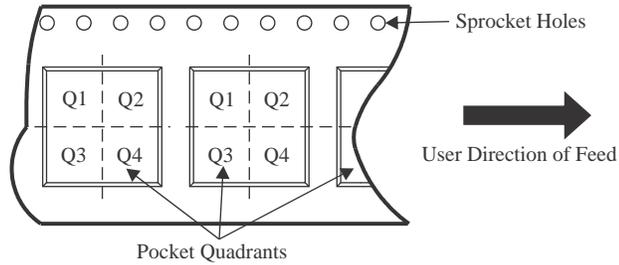
(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

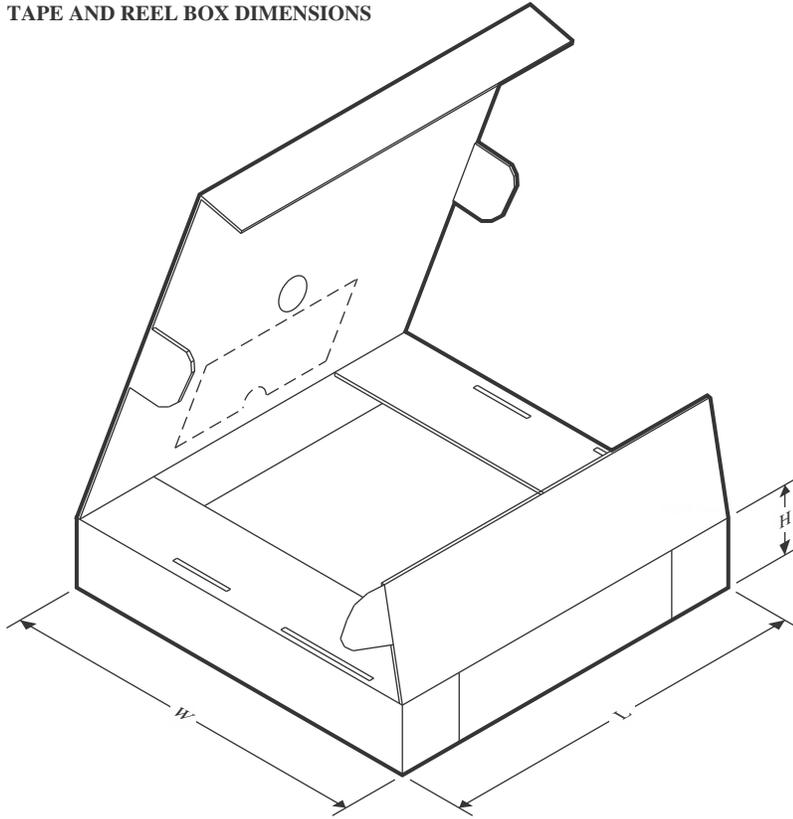
Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS92663QPWPRQ1	HTSSOP	PWP	24	2000	330.0	16.4	6.95	8.3	1.6	8.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS92663QPWPRQ1	HTSSOP	PWP	24	2000	350.0	350.0	43.0

GENERIC PACKAGE VIEW

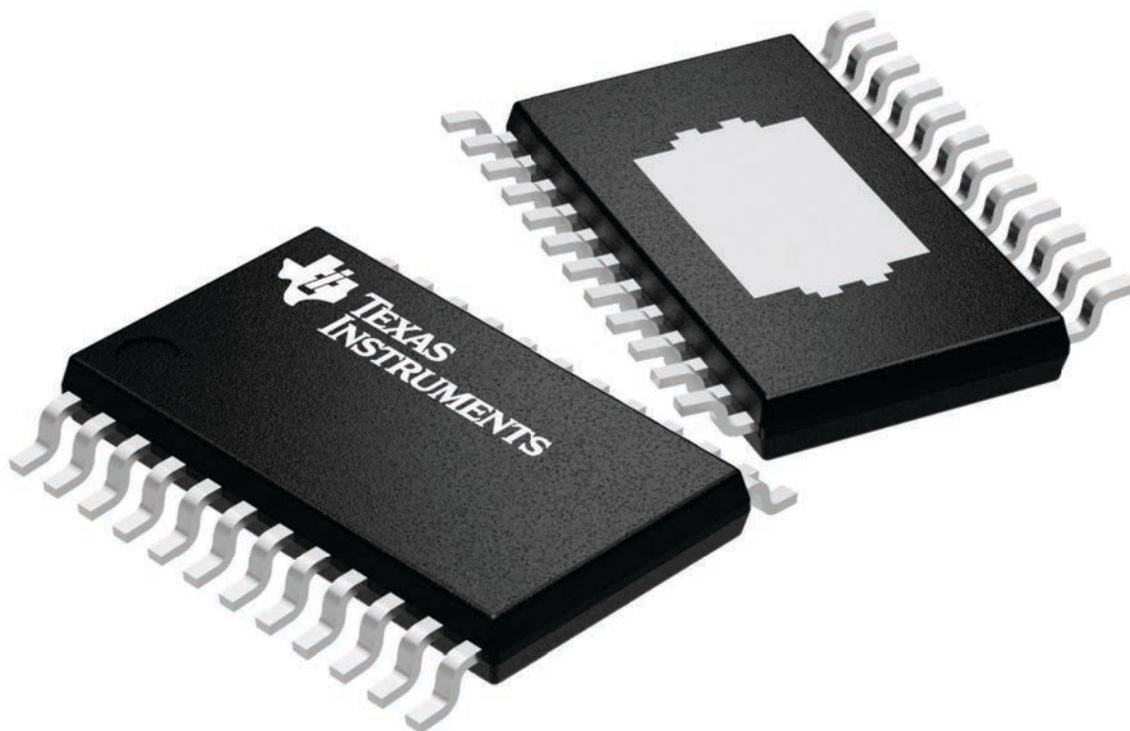
PWP 24

PowerPAD™ TSSOP - 1.2 mm max height

4.4 x 7.6, 0.65 mm pitch

PLASTIC SMALL OUTLINE

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4224742/B

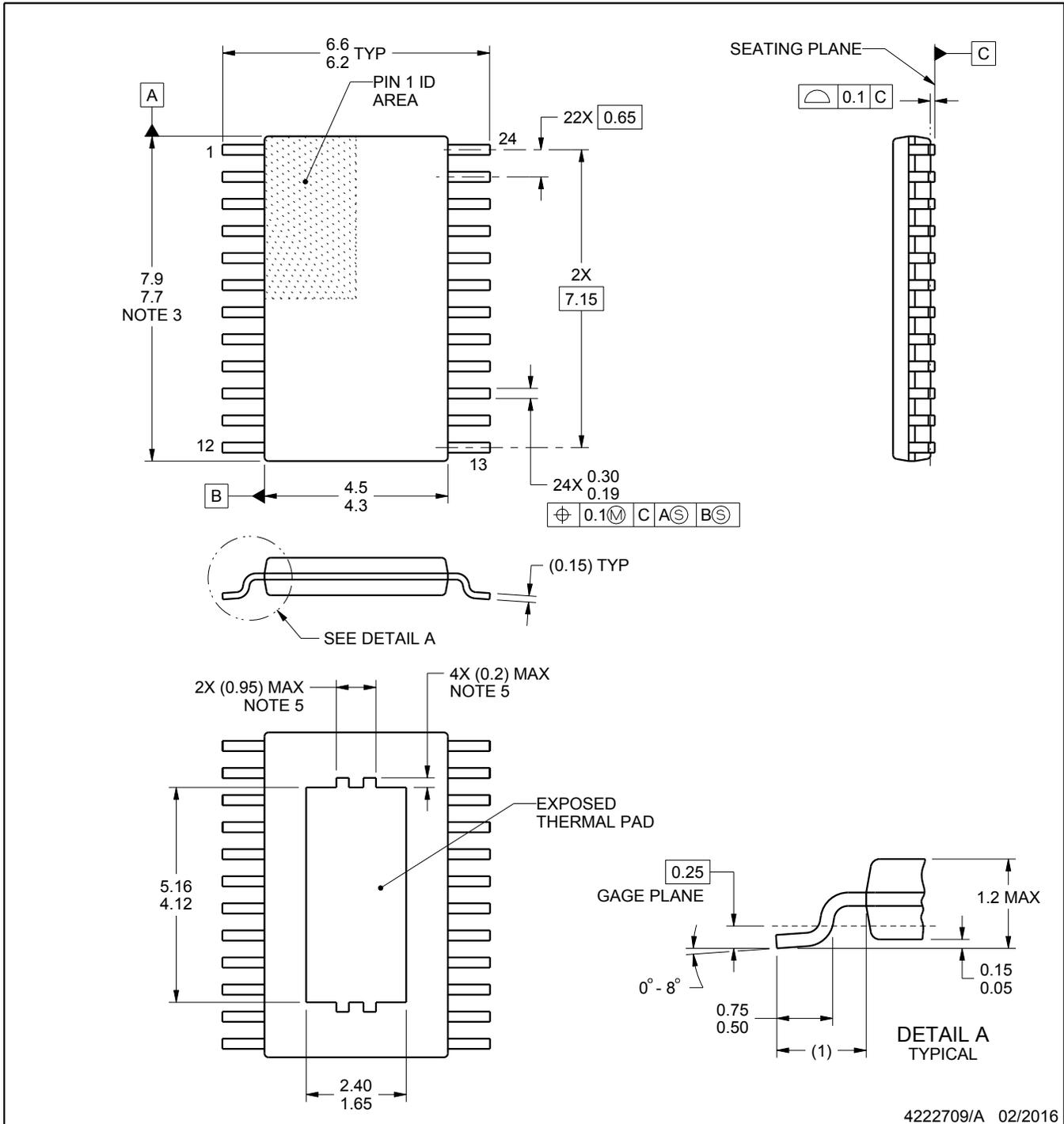
PWP0024B



PACKAGE OUTLINE

PowerPAD™ TSSOP - 1.2 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



4222709/A 02/2016

NOTES:

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

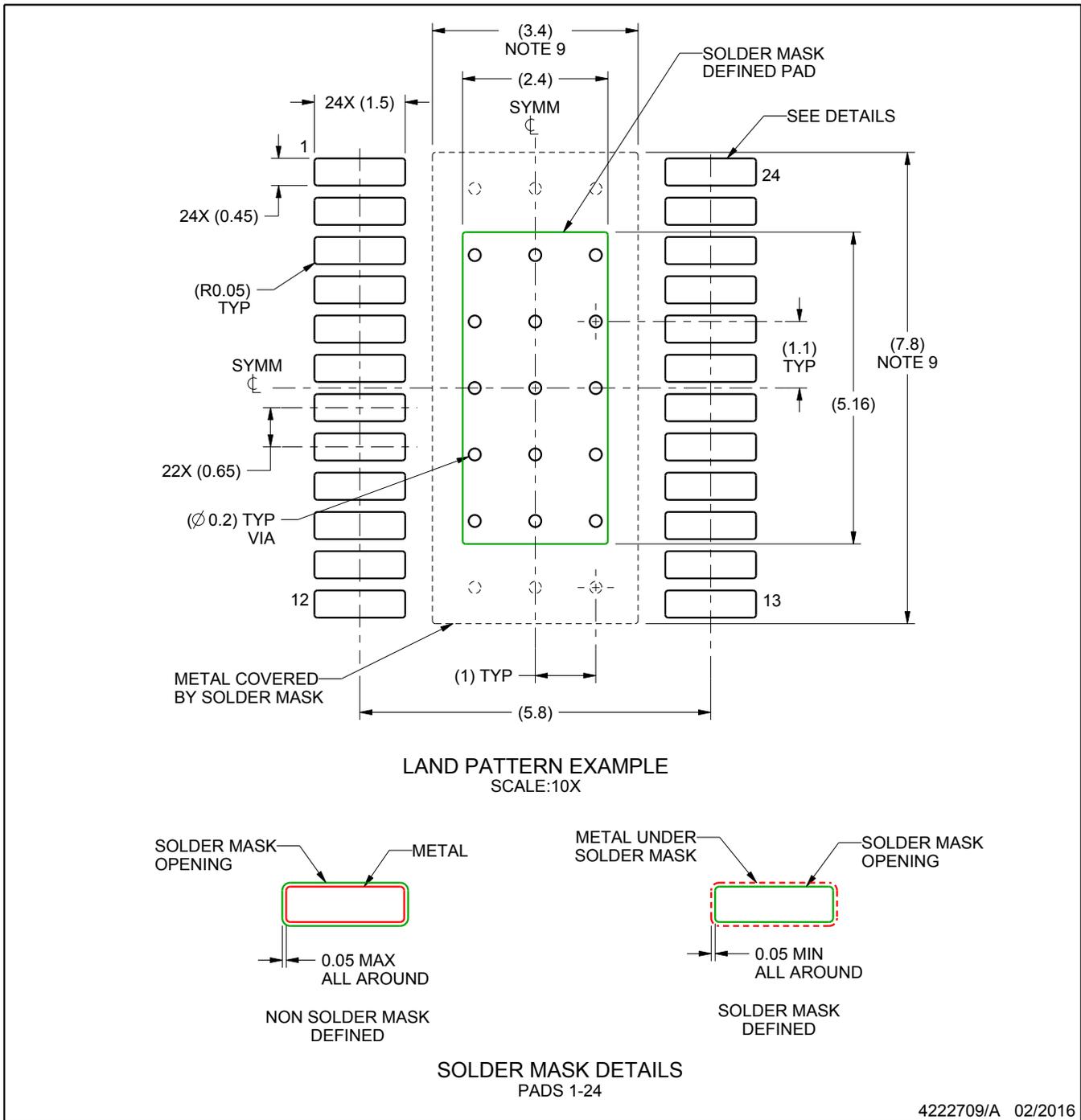
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-153.
5. Features may not be present and may vary.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

PWP0024B

PowerPAD™ TSSOP - 1.2 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



NOTES: (continued)

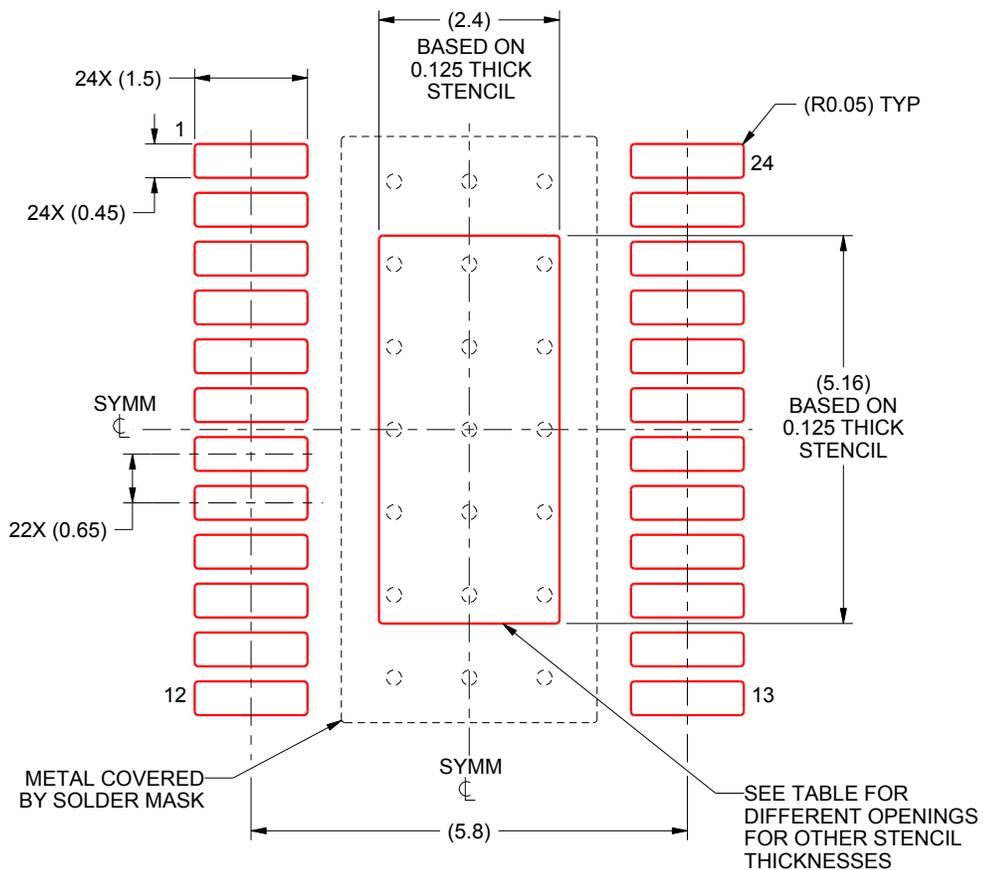
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature numbers SLMA002 (www.ti.com/lit/slma002) and SLMA004 (www.ti.com/lit/slma004).
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PWP0024B

PowerPAD™ TSSOP - 1.2 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



SOLDER PASTE EXAMPLE
 EXPOSED PAD
 100% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA
 SCALE:10X

STENCIL THICKNESS	SOLDER STENCIL OPENING
0.1	2.68 X 5.77
0.125	2.4 X 5.16 (SHOWN)
0.15	2.19 X 4.71
0.175	2.03 X 4.36

4222709/A 02/2016

NOTES: (continued)

- 10. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
- 11. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated